



**iesy GmbH**

Darmcher Grund 22

58540 Meinerzhagen

[www.iesy.com](http://www.iesy.com)

### **Pressemitteilung**

26.02.2021

Ansprechpartner: Thomas Frerich  
Telefon: +49 (2354) 70655 126  
E-Mail: [tho@iesy.com](mailto:tho@iesy.com)

## **Neuer Standard für Auflötmodule jetzt verfügbar**

### **Unternehmen iesy GmbH stellt erste Open Standard Module™ vor**

Meinerzhagen, 26.02.2021 – Die Firma iesy GmbH, Spezialist für kundenspezifische Embedded Systeme, stellt im Zuge der Messe embedded world 2021 DIGITAL vom 1.-5. März die ersten OSM-Module einer neuen Produktfamilie von Auflötmodulen vor. Im November 2020 wurde die Spezifikation für Open Standard Module™ – kurz OSM™ - von der SGeT e.V. verabschiedet. Um zukünftige Anforderungen hinsichtlich Miniaturisierung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz gerecht zu werden, sieht Martin Steger, Inhaber und Geschäftsführer der iesy GmbH, diese Module als eine wichtige Weiterentwicklung für den Markt eingebetteter Computer Module. „Neben dem breiten Leistungsspektrum der Module überzeugt vor allem der positive Effekt auf die

Kostenstruktur“, so Steger. So können dank OSM™-Auflötmodulen auf die jeweiligen Kundenanforderungen individuell mittels kundenspezifischer Basisboards eingegangen werden. Dazu können die Module im SMT-Bestückungsprozess vollautomatisch bestückt & weiterverarbeitet werden.

### **Vier Formfaktoren für verschiedene Anwendungsgebiete**

Die Auflistung von Vorteilen der Open Standard Module™ beginnt bereits bei dem kleinsten Modul der Baureihe. Mit einer Baugröße von gerade einmal 15 x 30 mm ist das Size-0 Modul kleiner als eine Briefmarke. Hinzu kommen drei weitere Modulgrößen mit den Abmessungen 30 x 30 mm (Size-S), 30 x 45 mm (Size-M) und 45 x 45 mm (Size-L). Dazu stehen per GitHub alle benötigten Treiber und BSPs für Yocto-Linux als Open Source Software zur Verfügung.

Als neuer Computer-on-Module Standard greifen auch bei OSM™ die bekannten Vorteile. So wird das Design-In komplexer Applikationsprozessoren vereinfacht, skalierbar und zukunftssicher.

### **Variable und ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen**

Mit seinen vier Größen sind die OSM's variabel hinsichtlich Schnittstellen und Leistungsspektrum. In der maximalen Konfiguration bilden die Open Standard Module™ alle Funktionen ab, die ein offenes programmierbares Embedded-, Edge- oder IoT-System maximal benötigt. Beispielsweise verfügen OSM-Auflötmodule ab Size-S bereits über

digitale & analoge Videoschnittstellen, mehrere Gbit LAN-Ports und ein Camera Serial Interface (CSI). Auf Modulen mit Size-L stehen insgesamt bis zu 79 Schnittstellen auf 662 Pins zur Verfügung. Davon sind speziell für herstellereinspezifische & zukünftige Erweiterungen 58 Signalepins reserviert.

Bei aktuellen Size-S Modulen setzt iesy zunächst auf NXP® sowie Rockchip® als CPU-Hersteller. Bei Size-0 Modulen findet ein ESP32 Microcontroller Verwendung. Wie gewohnt sind bei iesy kundenspezifische Entwicklungen durchaus gewünscht und zuverlässig realisierbar.

Ein weiterer konzeptioneller Vorteil von OSM™ ist die Möglichkeit zur beidseitigen Bestückung der Auflötmodule. Mit den Bezeichnungen „Flat“ und „Extended“ beschreibt der Standard ein modulares Konzept für den Höhengenaufbau.

Zusätzlich eignen sich die Open Standard Module™ auch als Retrofit-Lösung für bestehende Wireless-Applikationen. So verfügen die Auflötmodule teilweise über drahtlose Schnittstellen wie WLAN, Bluetooth oder Sub-1G.

### **Open Source Ansatz**

In Bezug auf Hardware als auch Software greift das Konzept einen Open Source Ansatz auf. Die Bereitstellung von Daten erfolgt zuverlässig revisioniert über ein Git-Repository - diese Daten stehen somit jedem Entwickler weltweit zur Verfügung. Ziel ist hierbei, ein hohes Maß an Transparenz zu ermöglichen und die Supportaufwendungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

### **Vorstellung auf der Embedded World**

„Zur embedded world 2021 DIGITAL stellen wir unter Beweis, dass wir die OSM™-Idee zu Ende gedacht haben“, so Martin Steger. Neben ersten Modulen für die Formfaktoren Size-0 und Size-S wird auch ein Evaluierungsboard im Mini-ITX Format vorgestellt. „Auf diesem Carrier sollen sich auch in Zukunft alle Open Standard Module™ auflöten und testen lassen“, so der iesy Geschäftsführer.

### **Fazit – OSM™ ist Realität geworden**

Mit den ersten drei eigenentwickelten OSM™-Computermodulen wird die iesy GmbH als eines der ersten Embedded Computing Unternehmen konkret in Sachen OSM™. Das auch bereits ein universell einsetzbares Carrierboard entwickelt wurde, zeigt, wie stringent und fokussiert die iesy das Thema Open Standard Module™ als embedded Spezialist umsetzt. Es wundert somit auch nicht, dass Martin Steger weitere Module in Aussicht stellt. „Mit diesen Modulen beweisen wir unseren Kunden, dass kundenspezifische Anforderungen und Kostenoptimierung kein Widerspruch darstellen muss. Dazu sind weitere, performante Module bereits in Planung“, so der iesy Geschäftsführer und verweist Module OSM™ mit Size-M und Size-L in der Konzeptphase.

Anlagen:

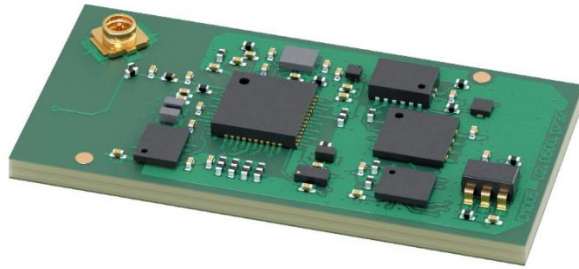


Abb. 1 – Size-0 Modul: iesy ESP32 OSM™-0F



Abb. 2 - Martin Steger (Geschäftsführer)